

FSP-501

- ・ FSP501はMicro Thinにプライマーレジンが塗布されたSAP用材料です。
FSP501 is SAP(Semi Additive Process) material which is coated primer resin on Micro Thin.
- ・ 微細回路形成に有効で、L/S=20/20以下の回路形成が可能です。
Usable for fine pitch pattern L/S=20/20 or less formation.

用途/Application

- ・ 半導体パッケージ基板
/Semiconductor Package

構成/Composition



生産拠点/Production Site

- ・ 日本 / Japan

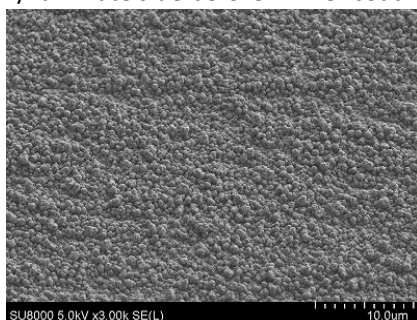
代表的特性値/Representative data

	μm	Area weight (w/o Primer) (g/m ²)	Laminate side Rz(μm)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)@FR-4
FSP501	1.5	18	1.4	-	-	-
	2	21	1.4	-	-	-
	3	30	1.4	-	-	-

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative data, not guarantee.

※Peel Strength は、35 μm までメッキアップした後の測定値
Evaluated after plated up to 35 μm

Primer塗工前ラミ面
/Laminate side before Primer coat



レジ面 /resist side

